

S3L4N3216162CRGB

16GB (2X8GB kit) S3+ DIMM DDR4 3200MHz RGB DRAGONHEART

Las memorias S3+[®] pasan rigurosos procesos de evaluación y pruebas ambientales. Nuestros módulos ofrecen una excelente compatibilidad y una fiabilidad absolutamente probada, ideal para actualizar su PC a un precio rentable.

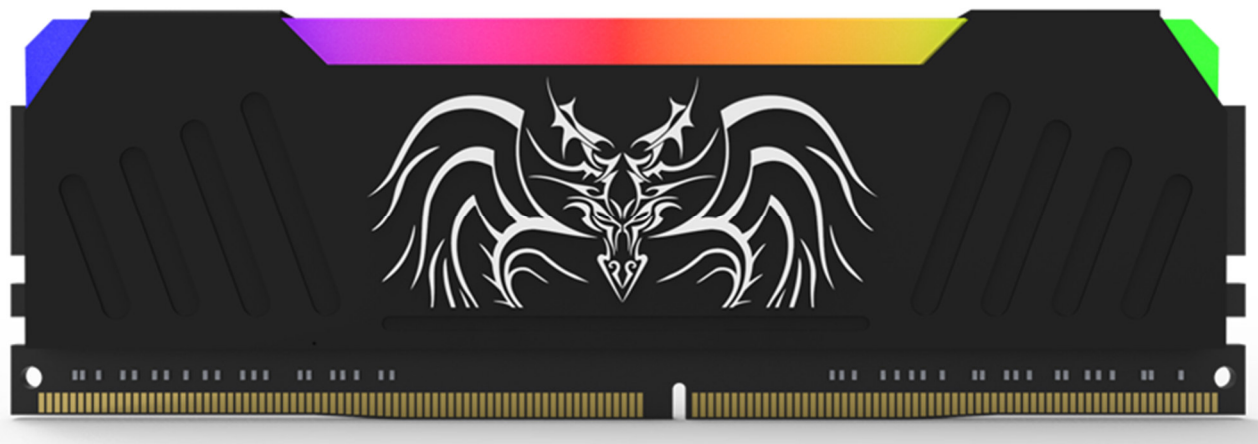
Descripción

DDR4 2666MHz 16GB es un kit de dos módulos de memoria DDR4-2666 CL16 SDRAM 1Rx8 de 1Gx64 bits, basado en dieciséis componentes FBGA de 8 chips de 1Gx8 bits por módulo. Cada kit de módulo es compatible con Intel[®] Extreme Memory Profiles (Intel[®] XMP) 2.0.

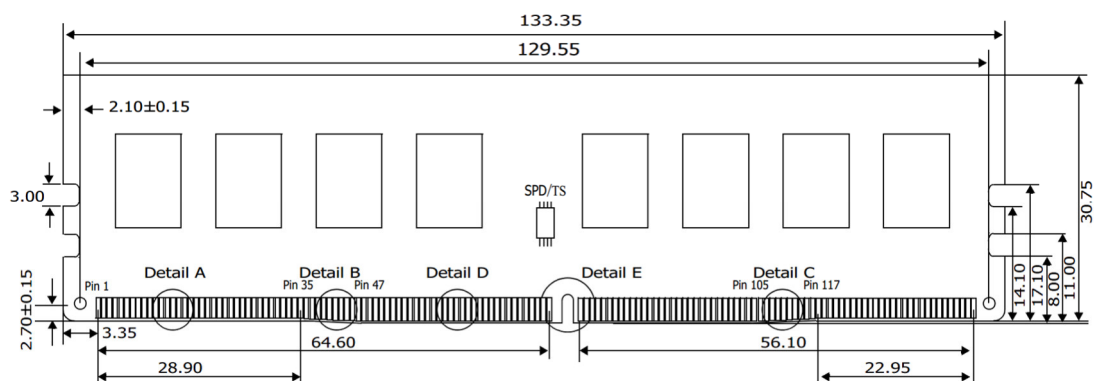
La capacidad total es de 16GB. Cada módulo ha sido probado para ejecutarse en DDR4-2666 con un tiempo de latencia baja de 16-18-18 a 1.35V. Los SPD están programados según el tiempo de latencia estándar DDR4-2400 de JEDEC de 17-17-17 a 1,2 V. Cada DIMM de 288 pines utiliza dedos de contacto dorados.

Características

- Fuente de alimentación: VDD = 1.2V Typical
- VDDQ = 1.2V Typical
- VPP = 2.5V Typical
- VDDSPD = 2.4V to 3.3V
- Terminación en matriz (ODT)
- Estroboscópico de datos diferenciales bidireccionales
- Búsqueda previa de 8 bits
- Interruptor de longitud de ráfaga (BL) on-the-fly BL8 o BC4 (Burst Chop)
- Efecto de rayo de onda RGB preestablecido de fábrica
- Altura 1.693" (43,10mm)
- PCB seleccionable: altura 1.23" (31.25mm)
- Cumple con RoHS y libre de halógenos



Dimensión Módulo



Especificaciones

CL (IDD)	16 ciclos
Row Cycle Time (tRCmin)	45.75ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)	350ns (min.)
Row Active Time (tRASmin)	32ns (min.)
Potencia de funcionamiento máxima	TBD W*
Clasificación UL	94 V - 0
Temperatura operativa	0° C a +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +85°C

*La potencia variará según la SDRAM utilizada